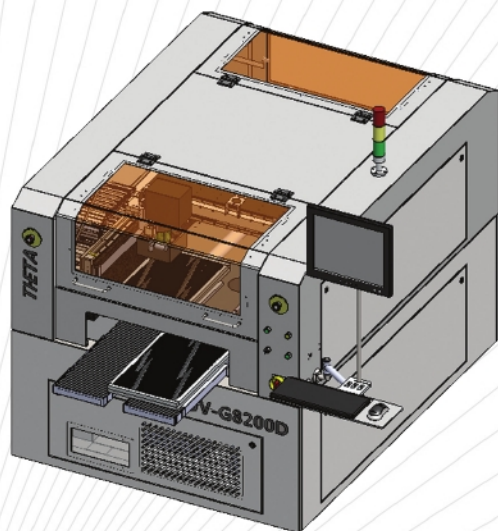




NEW

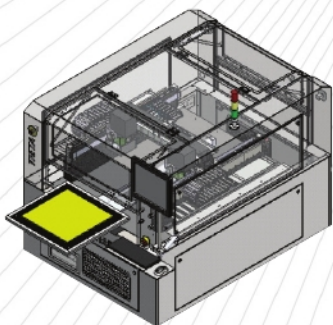
双工位紫外激光切割机

Double Station UV Laser Cutting Machine

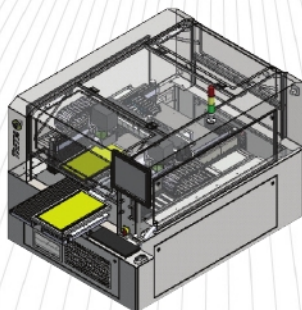


性能特点：

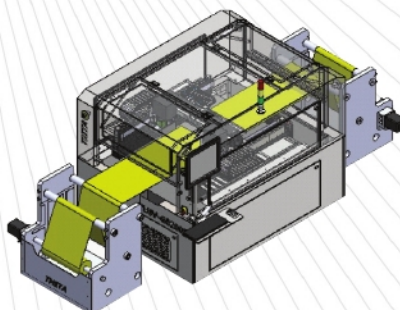
- 1. 光源及光学系统：**采用高光束质量、高峰值功率、窄脉宽、高脉冲稳定性半导体泵浦激光器，实现“冷”加工方式；优化设计的光学系统，实现低功率损耗，较小聚焦光斑尺寸，保证加工质量的稳定性和加工精度。
- 2. 平台运动系统：**采用双驱直线电机驱动梁式结构，全闭环数控系统控制，保证设备具有较高的加工速度、高的定位精度与重复精度。
- 3. 视觉系统：**配合软件高速图形对位处理算法，对材料常见的变形误差进行纠正，保证加工产品精度。
- 4. 天然花岗岩机台：**减小工作台启动、停止和加速过程产生的惯性震动，同时可保持机台长期使用精度的稳定性。
- 5. 软件系统：**配备智能激光微加工应用平台软件ThetaLaser，具有自主知识产权，界面友好，功能强大，操作简捷，软件模块可根据客户工艺定制化等优势。
- 6. 灵活的上料方式：**可兼容大幅面产品上料、双工位交替加工上料、卷对卷上料及标准在线上料等方式切割；满足代工、量产等各种生产需求；兼顾长短期的设备产能和投资效率。



TLS-G8200S



TLS-G8200D



TLS-G8200R

THETA 昆山思拓机器有限公司

地址：江苏省昆山市巴城镇红杨路888号
电话：+86-512-50352653/86167186
传真：+86-512-50352629
销售：sales@thetalaser.com
维修：services@thetalaser.com
网址：www.thetalaser.com

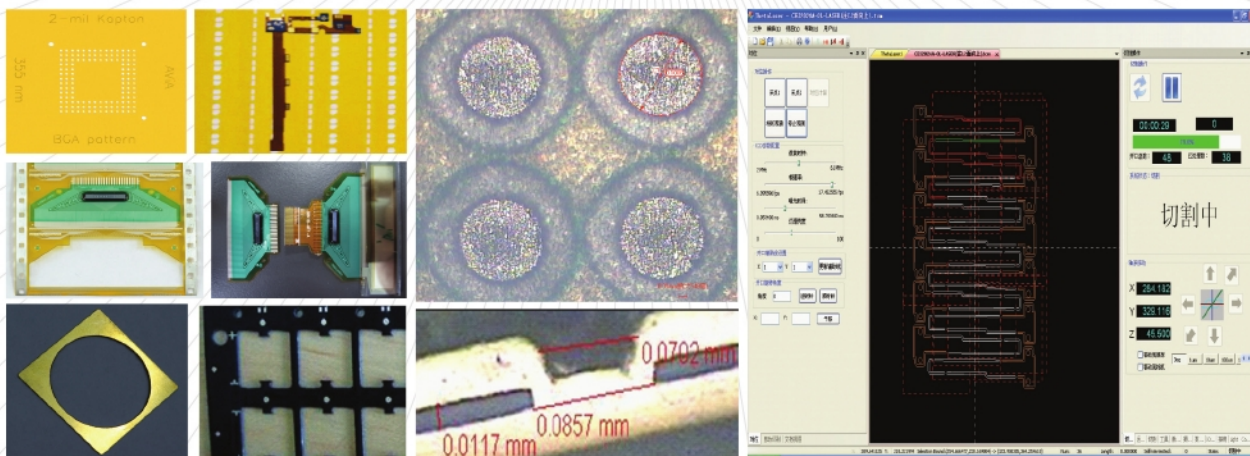
深圳办事处：
地址：广东深圳市宝安区福永街道
富桥第三工业区A4栋
电话：+86-755-81463062/29929570
传真：+86-755-29929557

TLS-G8200D

- 挠性电路板(FPC)、刚性电路板、刚-挠结合电路板和芯片封装基板的切割或分板
- 已安装元件的刚性、挠性电路板的分板加工
- 薄铜箔、压感粘接片(PSA)、PP、丙烯酸片、聚酰亚胺覆盖膜等精密切割及钻孔
- ITO薄膜、玻璃、有机薄膜、特种金属薄片、硅材料、蓝宝石等精密切割

技术规格: (3Sigma)

型号	TLS-G8200D
X/Y行程范围	600 × 800mm
X/Y平台定位精度	< ± 5μm
X/Y重复精度	± 1μm
加工范围	300mm × 600mm(双工位)，600mm*600mm(单工位)
X/Y平台最大运行速度	1000mm/s
激光功率	10W(8W，12W选配)
激光波长	355nm
激光频率	30-130KHz
环境温度	23 ± 3℃
环境湿度	20%~70%RH(无凝露)
兼容文件格式	Gerber, DXF, HPGL, Sieb&Meyer, Excellon, PCB
输入电压	380VAC ± 10%, 50/60Hz; 220VAC ± 10%, 50/60Hz
电功率消耗	2.5KW
压缩空气气压	0.5Mpa ≤ P ≤ 1.5Mpa
机器尺寸（长 × 宽 × 高）	1400mmx2400mmx1450mm
机器重量	2000Kg
产地	中国



THETA 昆山思拓机器有限公司

地址: 江苏省昆山市巴城镇红杨路888号
电话: +86-512-50352653/86167186
传真: +86-512-50352629
销售: sales@thetalaser.com
维修: services@thetalaser.com
网址: www.thetalaser.com

深圳办事处：
地址：广东深圳市宝安区福永街道
富桥第三工业区A4栋
电话：+86-755-81463062/29929570
传真：+86-755-29929557